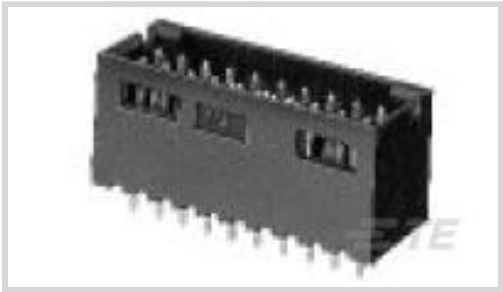




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 20

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	20
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性



端子底板材料	镍
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 µm[100 – 200 µin]
端子形状和构造	正方形
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	.381 µm[15 µin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	制动器窗口
接合固定	带有
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

--	--



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	176
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

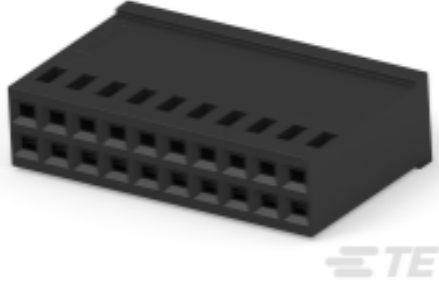
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (40% in 3433454) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

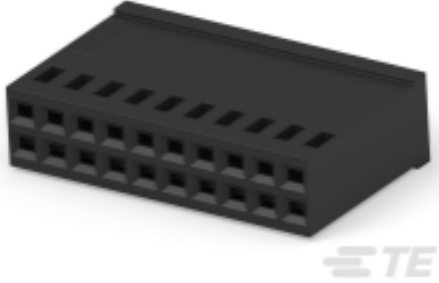




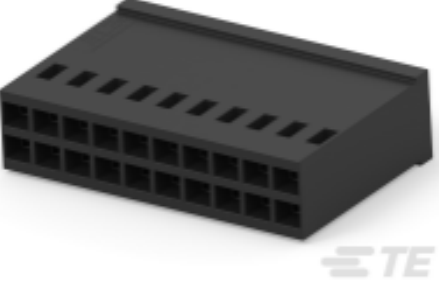
TE 产品编号 1-87456-6
20 MODIV HSG DR MRKD .100CL



TE 产品编号 87977-8
20 MODIV HSG DR MRKD .100 POL



TE 产品编号 1-87456-5
20 MODIV HSG COMP DR .100CL

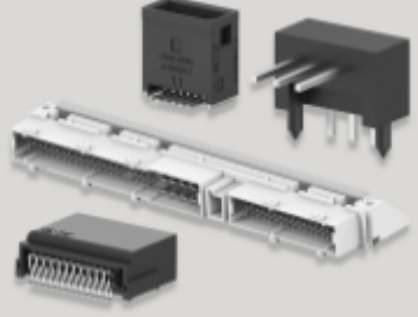


TE 产品编号 86177-1
20 MODIV HSG COMP DR .100CL

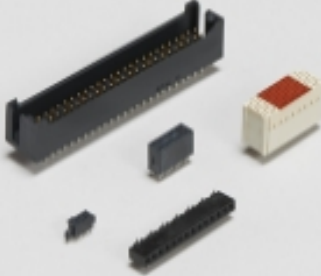


TE 产品编号 3-87977-5
20 MODIV HSG COMP DR .100 POL

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端



PCB 板端连接器及母端(1262)



板对板接头和插座(1227)



标准矩形连接器(2)



矩形电源连接器(25)



矩形连接器壳体(2)



线到板连接器组件和护套(2)



连接器硬件(1)



连接器端子(15)

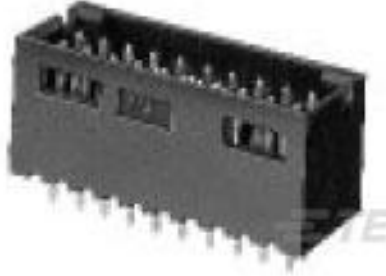
客户还购买了



TE 产品编号GA10K3CG3
CHPG-NTC CHIP THERMISTORS



TE 产品编号31425
TERMINAL,BUDG R 26-22 2



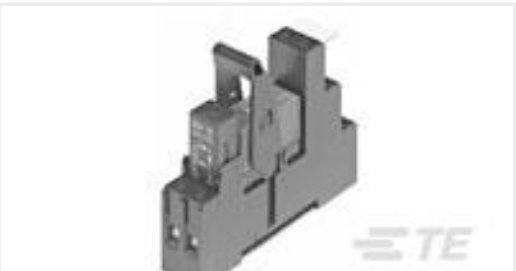
TE 产品编号5-102618-4
12 MODII HDR DRST SHRD .100CL



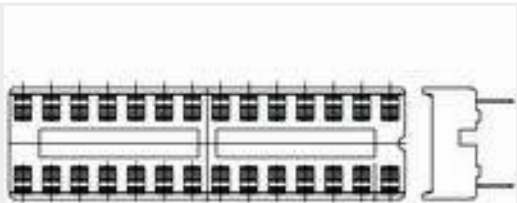
TE 产品编号6-102618-3
30 MODII HDR DRST SHRD .100CL



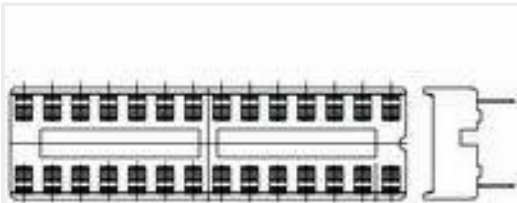
TE 产品编号749087-4
50SR SCREWLOCK KIT,FEMALE



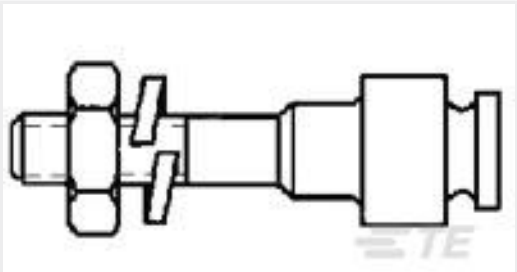
TE 产品编号1-1415073-1
RT4S4LC4



TE 产品编号1-2199298-1
6P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE



TE 产品编号1-2199298-6
20P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE



TE 产品编号5747242-1
AMPLI SLIDING LOCK POST KIT



TE 产品编号5749070-7
68 50SR VERT RCPT ASSY

文档

产品图纸

20 MODII HDR DRST SHRD .100CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_102618-8_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_102618-8_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_102618-8_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本